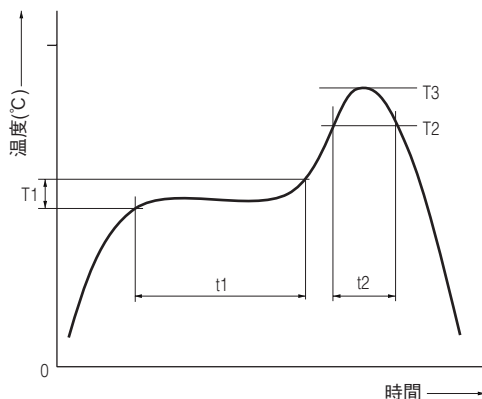


はんだ付け条件

■ リフローはんだ付け条件



● Sn-Pbはんだ 推奨温度プロファイル

タイプ名	プリヒート		はんだ付け		ピーク温度		リフロー回数
	T1 [°C]	t1 [s]	T2 [°C]	t2 [s]	T3	T3限界	
ELWCF	150~180	60~120	230 °C	40 max.	230 °C, 10 s	260 °C, 10 s	2回 max.

● 鉛フリーはんだ 推奨温度プロファイル

タイプ名	プリヒート		はんだ付け		ピーク温度		リフロー回数
	T1 [°C]	t1 [s]	T2 [°C]	t2 [s]	T3	T3限界	
ELWCF	150~180	60~120	230 °C	40 max.	250 °C, 10 s	260 °C, 10 s	2回 max.

■ フローはんだ付け条件

プリヒート 130 ~ 150 °C, 60 ~ 180 s, はんだ付け 260 °C, 5 s 以下で行ってください。

※ 高温高湿の環境下では端子電極の酸化により、はんだ付け性低下が加速する場合があります。
 また、良好な保存条件下でも時間経過とともににはんだ付け性は低下していきます。
 保存条件の管理を十分に行い、納入後6ヶ月以内に使用してください。